

## 通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-007

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）_____
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	北京泰德圣：王郑；北京赢家瑞乾：王嘉；财通基金：张宇、丁姝岑、朱玉柱；常州金融：李元杰、汤浩；辰致汽车：胡潇；广州金控：江洋金；广州穗开智造：吴史文；海南文泰：胡晓丽；华数数科：傅丹妮；惠州市创新投资：齐明俊；锐方私募：何宇翔、王俊兹；上海奔涌金控：尹训远；上海林拙：曹思杨；上海一村：陈天骏；上海证券通：夏阳、李亚真、李捷、刘强；苏州明善：魏梦楠；台州市资管：王以亮、郭远卓、陈俊伍；西安博成：邵嘉斌；西南证券：梁国荣、梁丹玥；招商基金：杨成；浙江吉晟：刘芮琪；浙江农发：傅笛轩；中国东方：陈海涛、王媛媛、朱一凡；上海杉玺：田永新；宁波和济：李昊悦、陶蓉；杭州瑞合泰：殷源蔚；西安博成：孙岩
<b>时间</b>	2026年6月23日
<b>地点</b>	公司会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书 蒋澍
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>一、公司概况</b></p> <p>通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD</p>

槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024 年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。

财务数据方面，公司 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年第一季度分别实现营收 222.69 亿元、238.82 亿元、279.21 亿元和 74.82 亿元。公司 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年第一季度的归母净利润分别为 1.69 亿元、6.78 亿元、12.19 亿元和 3.29 亿元。

## 二、投资者关注的主要问题

### 问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

问题 2：本次发行的股票数量是多少？有单个投资者的认购限制吗？

回复：本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 455,279,073 股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过 151,759,691 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 10%。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过 151,759,691 股（含本数），超过部分的认购为无效认购。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

### **问题 3：简单介绍一下现在封装测试行业概况。**

回复：封装测试是半导体芯片生产过程的最后一道工序，封装是指将晶圆（芯片）经切割后形成的晶粒，以塑料、陶瓷、金属等材料被覆，以保护晶粒避免受到外界污染。测试是指在完成封装后对半导体元件的功能、电参数进行测量，以筛选出不合格的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中的质量缺陷。通过封装测试可实现芯片的功率分配（电源分配）、信号分配、散热通道、隔离保护和机械支持等功能。

封装测试是集成电路制造产业链中至关重要的一个环节。因为芯片必须与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀从而造成电气性能的下降。同时，封装后的芯片也更便于安装和运输。封装是半导体集成电路与电路板的链接桥梁，封装技术的水平直接影响芯片的性能。

除自行完成封装与测试工序外，集成电路设计与制造企业也可将该环节委托于集成电路封装测试代工企业（OSAT）完成，从而用较低成本获得后端一流技术并加速产品上市进程。就 OSAT 厂商而言，具体可分为三大类，第一类是可提供多种封装类型且可封装芯片种类众多的综合类封测厂商，如发行人、日月光、安靠科技、长电科技、华天科技等；第二类是凭借若干技术专注于某细分领域的封测厂商，如硕中科技、汇成股份、硕邦科技、南茂科技等企业主要拥有凸块技术并以显示驱动芯片封测业务为主，又如晶方科技凭借 WLCSP 技术主要从事影像传感芯片的封测业务；第三类为主要从事集成电路测试环节的厂商，如

利扬芯片、京元电子、伟测科技等。

**问题 4：请问本次向特定对象发行股票后续还需要履行什么批准程序？**

回复：公司本次向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 6 月 3 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

**问题 5：请简单分析一下实施本次募投项目“存储芯片封测产能提升项目”有关政策方面的必要性。**

回复：半导体产业作为现代工业体系的核心支撑，其自主可控能力已上升为国家战略重点。近年来，国家密集出台《国家集成电路产业发展推进纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等多项政策文件，强调要围绕集成电路等重点领域开展全链条关键核心技术攻关，并持续从资金、人才等方面系统发力，推动产业基础高级化和产业链现代化，为国产替代创造了良好的政策和市场环境。

在上述政策与下游需求共振的背景下，存储芯片作为信息基础设施的“底座”，同时又是我国半导体产业的相对短板，成为半导体领域国产替代的重点方向之一。存储芯片具有较高的技术壁垒，体现在速率与容量、堆叠层数、先进制程与可靠性管理等方面，长期以来由美、日、韩等海外厂商主导。随着下游应用领域对高带宽、高容量、高可靠性存储的需求快速上升，国内市场形成了稳定且持续扩大的“增量+国产替代”空间。近年来，以长江存储、长鑫存储为代表的本土企业围绕堆叠层数、制程节点、控制器与固件算法优化等方向持续投入，具备了在重点应用领域实现规模化国产替代的技术与产业基础。公司加快建设和提升面向存储芯片的本土封测产能与技术，亦是保障国产存储芯片稳定供给和大规模导入应用场景的关键一环。

**问题 6：请简单分析一下本次募投项目“汽车等新兴应用领域封测产能提升项目”有关的下游发展机遇。**

回复：车载芯片的增长，核心逻辑来自整车电动化、电子电气架构升级、智能化配置渗透的同步推进。一方面，较传统汽车

	<p>而言，新能源汽车显著增加了单车在控制、电池管理、传感器、功率传输等环节的芯片用量；另一方面，整车电子电气架构正由分布式向域控制、集中式演进，催生 MCU、SoC、车载以太网、车规存储等高性能芯片需求，叠加智能座舱、辅助驾驶乃至高阶自动驾驶功能的普及，使得计算、控制及通信类芯片在更多车型上加速渗透。在此背景下，国内整车厂及 Tier1 厂商持续导入国产方案，叠加部分海外客户基于“China for China”的策略引导，车载芯片的封测产能和验证体系亦持续向境内转移。上述因素共同作用，推动车载芯片市场在中长期保持稳健增长，亦推动市场对车载芯片高可靠性封测产能的需求提升。</p> <p>综上，本土封测企业正迎来覆盖车载芯片全产品线的新增需求窗口。公司相关产能的利用率已处于较高水平，本募投项目通过提升车载芯片的封测产能，把握下游市场的快速发展机遇，提升营收规模及盈利水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 6 月 23 日